

多機能スパッタ膜

1. 背景と概要・目的

背景	◆ 『多機能スパッタ膜』を紹介する。 ◆ 独自の成膜技術により透明な材料に形成可能な光の透過量をコントロールできる薄膜技術を紹介する。
概要	• スパッタ技術の特徴 ① 高い密着性： 基板との密着性が高いため剥がれにくく耐久性がある。 ② 均一な膜厚： 真空中でプロセス制御可能であるため、大面積の基板や、表面の不均一な形状、ソフトマテリアルにも均一な膜厚を形成できる。 ③ 高い純度： 真空中でのプロセスのため、不純物の混入が少なく、高純度な膜が形成可能。 ④ 薄膜構造の制御性： 薄膜の組成や結晶構造を制御し易く、様々な物理的・化学的特性を持つ膜、多層膜、合金膜の形成に適する。 ⑤ 広範な材料に対応： 金属、半導体、絶縁体など、多様な材料を用いた薄膜形成が可能。 ⑥ 環境に優しい： スパッタリングは化学薬品を使用しないため、環境負荷が比較的少ないプロセスとされている。
目的	◆ 多機能スパッタ膜の適用候補を募集する。 ◆ 本技術に対する要望やコメントを募集する。